

【コンテンツ情報】

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 連番          | 00027585  |  |
| 素材 ID       | M000462-22  |  |
| 国名または地域     | 北米（米州）  |  |
| コンテンツ名      | 【北米】経営管理  |  |
| カテゴリ名       | 仕事に役立つ！アメリカ法律解説   |  |
| コンテンツ提供会社名  | スミス・ガンブレル・ラッセル（SGR）法律事務所  |  |
| 提供元サイト URL  | <a href="https://sgrlaw.com/practices/japan-practice-team/">https://sgrlaw.com/practices/japan-practice-team/</a> |  |
| 国区分         | 米・アメリカ  |  |
| タイトル        | 米国 CHIPS インセンティブ・プログラムの概要   |  |
| 書下ろし/二次利用   | 書下ろし  |  |
| PDF         | なし  |  |
| 記事内問い合わせボタン | なし  |  |
| 公開終了日パターン   | B：設定なし（永久掲載）  |  |
| CMS 目的別フラグ  | 設定なし  |  |
| CMS 地域フラグ   | 北米  |  |
| 区分          | BizBuddy  |  |
| 執筆者         | 小島清顕、岡本駿之、白水真祐  |  |
| 執筆日         | 2023 年 12 月 30 日  |  |
| PDF ファイル名   | .pdf  |  |
| プロフィール変更    | 新規作成（岡本駿之、白水真祐）   | M000462_okamoto_prof02.png<br>M000462_shiromizu_prof.png |
| 提供者名変更      | なし  |  |
| URL 変更      | なし  |  |

【概要】 ※165 文字程度目安

(171 文字)

2022 年、米国商務省において CHIPS インセンティブ・プログラムが設立されました。本プログラムは、半導体のグローバルサプライチェーンに大きな影響を及ぼすことが予想されます。在米日系企業からは、申請者が順守すべき条件等が想定以上に厳しいとの見方がある一方、サプライチェーン上流への発注が増える可能性を期待する声もあり、今後の動向が注目されます。

2022年、米国商務省において、半導体の製造等または研究開発における米国の地位を強化するため、米国内の施設および設備への投資を行うプロジェクトに対して5年間で合計390億ドルの資金援助の機会を提供するCHIPS インセンティブ・プログラム（以下「本プログラム」）が設立されました。本プログラムのもと、2023年2月に第1弾（同年6月に対象範囲を拡張）、同年9月に第2弾の資金援助機会が公表されています。

本プログラムに基づく資金援助を受けるには、後述するCHIPS法および資金援助機会通知（Notice of Funding Opportunity：以下「NOFO」）に記載される要件を満たす必要がある他、中国等の懸念国に利益をもたらすことを防ぐガードレール（Guardrails）として、商務省と一定の条件を含む合意書を締結する必要があります。

本稿では、本プログラムの背景（第1項）、本プログラムの概要（第2項）、NOFO第1弾の概要（第3項）、NOFO第2弾の概要（第4項）、ガードレールの概要（第5項）について解説します<sup>1</sup>。

## 1. 本プログラムの背景

2021年1月1日にドナルド・トランプ前大統領政権下で成立した2021会計年度ウィリアム・M（マック）・ソーンベリー国防授權法（The William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021：以下「2021会計年度NDAA」）の第99章（Title XCIX）「米国のための半導体製造を支援するインセンティブの創出」（Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America：CHIPS for America）により、商務長官において、半導体の製造、組立、試験、先端パッケージング、または研究開発のための米国内の施設・設備への投資を奨励するための資金援助を提供するインセンティブ・プログラムを設けること等が定められました<sup>2</sup>。

これを受けて、ジョー・バイデン大統領は2022年8月9日、超党派のCHIPSおよび科学法（CHIPS and Science Act of 2022）に署名しました<sup>3</sup>。同法は、上述した2021会計年度NDAA第99章を修正すると共に、これを実施すべく、2023～2027会計年度の国内半導体産業支援策に係る予算として合計527億ドルの連邦資金を充当するものです（以下、CHIPSおよび科学法により修正された2021会計年度NDAA第99章を「CHIPS法」）。当該予算の内訳は以下のとおりです。

### a. 米国CHIPSファンド（CHIPS for America Fund）：合計500億ドル

- ・本プログラムに関する予算：合計390億ドル

- ・国立半導体技術センター (National Semiconductor Technology Center : 以下「NSTC」)<sup>4</sup>の設置に関する予算 : 合計 110 億ドル
- b. 米国防衛 CHIPS ファンド (CHIPS for America Defense Fund) : 合計 20 億ドル
- c. 国際情報通信技術セキュリティ・技術革新 CHIPS ファンド (CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund) : 合計 5 億ドル
- d. マイクロエレクトロニクス人材開発 CHIPS ファンド (CHIPS for America Workforce and Education Fund) : 合計 2 億ドル

## 2. 本プログラムの概要

本プログラムは、対象となるプロジェクトに対し、資金援助（直接資金、貸付、または貸付保証）の機会を提供するものです。本プログラムの予算管理および運営は、商務省の国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and Technology : 以下「NIST」) 内に置かれる CHIPS プログラム事務局 (CHIPS Program Office : CPO) が担っています。

### (1) 資金援助の種類

本プログラムにより提供される資金援助には以下の 3 種類があり（以下、総称して「CHIPS インセンティブ」）、申請者は、申請を行う際に、希望する CHIPS インセンティブの種類および金額を記入することになります。なお、1 つの申請に対して 2 種類以上の CHIPS インセンティブを付与することも可能とされています<sup>5</sup>。

- a. **直接資金 (Direct Funding)** : 連邦政府が申請者に直接資金を交付するもの（補助金、協力協定、またはその他の取引による）。
- b. **貸付 (Loans)** : 連邦政府が申請者に直接融資を行うもの。
- c. **貸付保証 (Loan Guarantees)** : 連邦政府が申請者に対する第三者による融資の保証を行うもの。

### (2) 具体的な資金援助機会

これまでに公表された資金援助機会および今後予定されている資金援助機会は、以下のとおりです。

- a. **第 1 弾 : 半導体の商業製造施設および半導体材料・製造装置の大規模サプライヤー**  
2023 年 2 月 28 日、CHIPS プログラム事務局は、第 1 弾の資金援助機会通知 (Notice of Funding Opportunity : 以下「NOFO」) を公表しました<sup>6</sup>。第 1 弾では、最先端・現世代・成熟ノード半導体の製造（前工程のウエハー製造と後工程の組立、テスト、パッケージングの両方を含む）のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクトが

対象とされています。また、2023年6月23日、その対象範囲が拡張され、資本投資額が3億ドル以上の半導体材料および製造装置のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクトも含まれることになりました（以下、拡張されたNOFOを「NOFO第1弾」）<sup>7 8</sup>。

#### **b. 第2弾：半導体材料・製造装置の小規模サプライヤー**

2023年9月29日、CHIPSプログラム事務局は、第2弾の資金援助機会通知を公表しました（以下「NOFO第2弾」）<sup>9</sup>。NOFO第2弾では、資本投資額が3億ドル未満の半導体材料および製造装置のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクトが対象とされています。

#### **c. 公表予定：研究開発施設**

NOFO第2弾では、CHIPSプログラム事務局は後日、研究開発施設（R&D Facilities）に関するプロジェクトを対象とする追加的な資金援助機会を公表する予定である旨が示されました。ただし、資本投資額が2,000万ドル未満のプロジェクトが基準を満たす見込みは低いとされています<sup>10</sup>。

### **3. NOFO第1弾の概要**

上述したとおり、NOFO第1弾は、最先端・現世代・成熟ノード半導体の製造（前工程のウエハー製造と後工程の組立・テスト、パッケージングの両方を含む）のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクト、ならびに資本投資額が3億ドル以上の半導体材料および製造装置のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクトを対象とするものです。

#### **(1) 主な日程**

- a. 全申請希望者：2023年2月28日に関心表明書（任意・推奨）の受付開始
- b. 最先端半導体のための施設：2023年3月31日に事前申請および正式申請の受付開始
- c. 現世代・成熟ノード半導体、後工程のための施設：2023年5月1日に事前申請の受付開始、同年6月26日に正式申請の受付開始
- d. ウエハー製造施設：2023年9月1日に事前申請の受付開始、同年10月23日に正式申請の受付開始
- e. 設備投資額が3億ドル以上の半導体材料および製造装置のための施設：2023年9月1日に事前申請の受付開始、同年10月23日に正式申請の受付開始

#### **(2) 申請プロセス**

NOFO 第 1 弾の申請プロセスは、以下の 5 つのステップにより構成されています。

**a. 関心表明書の提出 (Statement of Interest)**

申請希望者は、事前申請書または正式申請書を提出する 21 日前までに、計画中の申請内容を簡潔に説明する関心表明書を提出する必要があります。商務省は、これによりプログラムに対する関心度を測定し、事前申請や正式申請の審査の準備を進めることとなります。

**b. 事前申請 (任意・推奨) (Recommended Pre-Application)**

申請希望者は、任意で、関心表明書よりも詳細な申請内容の説明が記載された事前申請書を提出することが推奨されています。同ステップは、商務省と申請希望者との対話の機会を設け、申請書が NOFO 第 1 弾の要件を満たし、優先事項に対応していることを確保するためのものです。同ステップでは、事前申請書の強み・弱みや改善点に関する評価書が申請者に交付されることがあり、これには、①事前申請の修正版を提出すること、②正式申請を提出すること、もしくは③事前申請または正式申請を提出しないこと等、次のステップに係る勧告が記載されます。

**c. 正式申請 (Full Application)**

正式に選考を受けるためには、プロジェクトに関する広範かつ詳細な情報が記載された正式申請書を提出する必要があります。正式申請書の提出には多大なリソースを要するため、商務省は、事前申請に対するフィードバックを十分に考慮することを推奨しています。同ステップにおいて、商務省は、申請者に対してさらなる情報や説明を求め、フィードバックを行います。また、付与決定を行う可能性がある場合には、申請者と暫定的な条件を交渉した上、拘束力のない予備的覚書 (Preliminary Memorandum of Terms) を申請者に提示します。

**d. デューディリジェンス (Due Diligence)**

商務省において CHIPS インセンティブの付与決定がなされる可能性が十分にあると判断し、かつ、商務省と申請者が予備的覚書について合意したか、または合意する見通しである場合、当該申請は包括的なデューディリジェンスのステップに進みます。商務省は、申請者に対し、国家安全保障、財務、環境等の問題に関する追加情報の提供を求めます。また、商務省は外部のアドバイザー、コンサルタント、弁護士を起用し、申請者はその手数料および費用を負担することとなります。デューディリジェンスが実質的に完了すると、商務省は、申請者と予備的覚書よりさらに詳細な長文タームシート (Long-Form Term Sheet) の条件を交渉します。

#### e. 付与決定の準備および発行 (Award Preparation and Issuance)

商務省が申請者に CHIPS インセンティブを付与することを決定した場合、最終的な付与決定の条件は、デューディリジェンスの最終結果、申請全体の分析、およびさらなる交渉の経過により決定されます（長文タームシートに実質的に整合する内容となることが想定されます）。なお、各プロジェクトに対して付与される CHIPS インセンティブの金額は、原則的に 30 億ドルを超えてはならないものとされています。

### (3) 優先事項

付与決定を受けるためには、優先事項 (Program Priorities) を充足する必要があります。NOFO 第 1 弾における優先事項は、概要、以下のとおりです。

#### a. 経済安全保障および国家安全保障に関する目的 (Economic and National Security Objectives)

米国の経済安全保障および国家安全保障の促進は、CHIPS インセンティブ・プログラムの主要な目的と位置付けられています。

経済安全保障について、商務省は、米国の半導体生産を増加させ、米国および同盟国のサプライチェーンを強化するプロジェクト、特に地理的・地政学的リスクを軽減させるプロジェクトへの投資に重点を置くとしています。また、最先端半導体の施設については、最先端の商業技術を活用し、米国の経済競争力にとって重要な製品を生産するプロジェクトが求められており、民間投資と技術革新の好循環を確立することに重点が置かれています。さらに、現世代・成熟ノード半導体の施設については、米国の経済安全保障に不可欠な半導体の生産を支援するプロジェクトが求められています。

国家安全保障について、商務省は、安全で確実な国産チップへのアクセスという政府機関の政策上のニーズを満たすプロジェクトへの援助に注力するとしています。また、半導体および半導体サプライチェーンに対する悪意ある攻撃への対抗力が高い申請者や、リスク管理戦略を通じた強靱性が実証されたプロジェクトが求められています。さらに、製造工程の上流または下流の工程の所在地における国家安全保障上のリスクも考慮されます。

また、商務省は、20 億ドル以上を成熟ノードに対する生産支援に充当するとしています。特に、米国内の重要製造業<sup>11</sup>の半導体サプライチェーンの強靱性を支える施設に関する申請が優先されます。

#### **b. 商業的実行可能性 (Commercial Viability)**

申請者は、生産される半導体技術、材料、または装置の種類を説明し、また、生産物の顧客、または顧客のカテゴリを特定する必要があります。なお、商業的実行可能性に関する戦略は、プロジェクトの対象となる施設の耐用年数を通じて適用されなければなりません。

#### **c. 財務力 (Financial Strength)**

本プログラムは単独で十分な資金を提供する趣旨のものではなく、申請者は、民間からの資金調達を最大化し、CHIPS インセンティブの必要性を最小化する方法によりプロジェクトの財務面を構成すべきとされています。商務省は、申請者が民間資金を最大限に活用するために取った措置に照らして十分な努力が示されない場合には、CHIPS インセンティブの付与を拒否することがあります。また、申請者は、財務面に関する包括的評価のため、財務モデルを提出する必要があります。

#### **d. プロジェクトの技術的実現可能性および準備 (Project Technical Feasibility and Readiness)**

プロジェクトの技術的実現可能性には、申請者が提案されたプロジェクトを建設、装備、および運用する能力が含まれます。技術的実現可能性を証明するため、申請者は、主要な建設・運用のマイルストーン、建設に係る権利・許認可、および主要な契約を含む、明確な実行計画の提出を求められます。また、申請者は、提案されたプロジェクト、およびプロジェクト内の個々の活動について、必要な環境コンプライアンスおよび許認可のステップを特定する必要があります。

#### **e. 労働力開発 (Workforce Development) <sup>12</sup>**

施設労働者について、申請者は、自らの施設において良い仕事 (Good Jobs) に従事する多様な労働力の募集、訓練、雇用、維持、技能向上のため、適切な投資を行う旨を約束すべきとされています<sup>13</sup>。また、セクター別パートナーシップ (Sectoral Partnerships)のもと、質の高い公平な労働力開発計画 (Workforce Development Plan) の策定および実施が必要とされています。

建設労働者について、申請者は、多様かつ熟練の建設労働力を募集、訓練、雇用、維持するために申請者とその建設パートナーが講じる措置について記載する建設労働力計画 (Construction Workforce Plan) を提出する必要があります。また、商務省は、建設プロジェクトに関するプロジェクト労働協約 (Project Labor Agreement : PLA) の利用を強

く推奨しており、同協約を利用しない場合には、労働力継続計画（Workforce Continuity Plan）を提出し、遅延リスク軽減措置を講じたことを示すよう求めています。

この他、経済的に恵まれない人々の雇用機会を拡大するため、商務省は、1億5,000万ドルを超える CHIPS 直接資金を申請する申請者に対し、施設労働者および建設労働者がチャイルドケアを利用するための計画を提出するよう求めています。

#### **f. 広範な影響（Broader Impacts）**

以上の他、商務省は、以下の事項に関する広範な影響についても考慮するとしています。

- ・ 米国半導体産業への将来投資の約束
- ・ アップサイド・シェアリング<sup>14</sup>
- ・ CHIPS 研究開発プログラムへの支援
- ・ 企業のための包括的な機会の創出<sup>15</sup>
- ・ 気候および環境責任
- ・ 地域社会への投資
- ・ 国内製造およびその内容<sup>16</sup>

### **4. NOFO 第 2 弾の概要**

上述したとおり、NOFO 第 2 弾は、資本投資額が 3 億ドル未満の半導体材料および製造装置のための商業施設の建設、拡張、または近代化に関するプロジェクトを対象とするものです。

#### **(1) 主な日程**

- 全申請希望者**：2023 年 12 月 1 日から 2024 年 2 月 1 日までコンセプトプランを受理。
- コンセプトプラン申請により正式申請審査に進むことが決まった者**：CHIPS プログラム事務局より正式申請書の提出日を個別に連絡。
- NOFO の変更および終了**：商務省はいつでも NOFO を変更できる他、60 日以上前に通知することにより、資金援助機会を終了することができる<sup>17</sup>。

#### **(2) 申請プロセス**

NOFO 第 2 弾の申請プロセスは、以下の 4 つのステップにより構成されています。

##### **a. コンセプトプラン審査（Concept Plan Review）**

コンセプトプラン（当該プロジェクトが優先事項に対応していることを説明するもの）について、適格性（Eligibility）、完全性（Completeness）、および適応性

(Responsiveness) に関する初期審査が行われ、これらを満たさないコンセプトプランは却下されます<sup>18</sup>。その後、3名以上の独立審査員がコンセプトプラン評価基準 (Concept Plan Evaluation Criteria)<sup>19</sup>に基づいて採点し、投資委員会 (Investment Committee) において、当該点数および選考要素 (Selection Factors)<sup>20</sup>に基づき、①正式申請審査に進むべき旨、または②正式申請審査に進むべきではない旨の書面決定を行います。

#### **b. 正式申請審査 (Full Application Review)**

正式申請について、コンセプトプラン審査と同様の初期審査が行われます。その後、投資委員会が正式申請評価基準 (Full Application Evaluation Criteria)<sup>21</sup>に基づく質的評価を行い、最終的に、質的評価、プログラム要件、評価基準、優先事項、および選考要素に基づき、①付与決定を受ける資格があると思料され、デューディリジェンスに進むべき旨、②付与決定を受ける資格があると思料され、さらなる検討のために保留すべき旨、または③申請を却下すべき旨の書面決定を行います。

#### **c. デューディリジェンス (Due Diligence)**

国家安全保障上のリスク、財務・商業情報、環境への影響、およびその他の問題についてデューディリジェンスが行われます。商務省は申請者または第三者から必要な情報を収集し、投資委員会はこれを通じて最新の情報を受領します。商務省は、各種コンサルタント、請負業者、外部法律顧問等を利用することがあり、申請者にその費用の支払いを求めることがありますが、このような支払いに同意しない申請者は申請を取り下げることができます。デューディリジェンスが実質的に完了すると、商務省は、申請者と CHIPS インセンティブに適用される条件を交渉します。

#### **d. 付与決定の準備および発行 (Award Preparation and Issuance)**

デューディリジェンスが完了すると、投資委員会は、申請を承認する選定当局に対して当該申請を推薦します。選定当局の担当者は、投資委員会の推薦を受諾、修正、または拒否することができる他、さらなる評価、交渉、デューディリジェンスのために差し戻すこともできます。CHIPS インセンティブの付与決定は、NIST の承認担当官によるフォーム CD-450 または同等の付与決定の発行をもって行われます。この付与決定は終局的なものであり、異議を申し立てることはできません。

### **(3) 優先事項**

NOFO 第2弾における優先事項は、概要、以下のとおりです。

#### **a. 経済安全保障および国家安全保障に関する目的 (Economic and National Security Objectives)**

上述したとおり、米国の経済安全保障および国家安全保障の促進は、CHIPS インセンティブ・プログラムの主要な目的と位置付けられています。

経済安全保障について、商務省は、①サプライチェーンの強靱性の強化、②半導体材料・製造装置における米国の技術リーダーシップの促進、③活力ある米国製造クラスターの支援の3つの目的を掲げ、中でも③を重視しています。特に、コンソーシアムの一員として申請することが奨励または歓迎されています。また、商務省は、研究開発のための堅牢なイノベーション・エコシステムの強化に寄与する申請者を求めており、NSTCに参加する場合や国家先端パッケージング製造プログラム (National Advanced Packaging Manufacturing Program : NAPMP) が資金を提供するプロジェクトと連携する場合は、申請の優位性が高まるとされています。

国家安全保障について、CHIPS プログラム事務局は申請者に対し、当該プロジェクトが支援する国家安全保障プログラムやプラットフォーム、防衛産業基盤の顧客、国家安全保障の促進について検証できる政府の連絡窓口を特定するよう奨励しています。また、商務省は、半導体および半導体サプライチェーンに対する悪意ある攻撃への対抗力が高い申請者や、リスク管理戦略を通じた強靱性が実証されたプロジェクトを求めています。さらに、製造工程の上流または下流の工程の所在地における国家安全保障上のリスクも考慮されます。

#### **b. 商業的実行可能性 (Commercial Viability)**

申請者は、生産される半導体材料や装置の種類、半導体製造プロセスにおいてその技術が使用される段階、および主要な半導体・非半導体の最終市場について説明する必要があります。また、生産物に対する購入の約束や顧客需要の証拠がある場合には、申請の優位性が高まるとされています。

#### **c. 財務力 (Financial Strength)**

本プログラムは単独で十分な資金を提供する趣旨のものではなく、申請者は、民間からの資金調達を最大化し、CHIPS インセンティブの必要性を最小化する方法によりプロジェクトの財務面を構成すべきとされています。商務省は、申請者が民間資金を最大限に活用するために取った措置に照らして十分な努力が示されない場合には、CHIPS インセンティブの付与を拒否することがあります。また、申請者は、財務面に関する包括的評価のため、財務モデルを提出する必要があります。

#### d. プロジェクトの技術的実現可能性および準備 (Project Technical Feasibility and Readiness)

プロジェクトの技術的実現可能性には、申請者が提案されたプロジェクトを建設、装備、および運用する能力が含まれます。技術的実現可能性を証明するため、申請者は、建設スケジュール、主要パートナー、請負業者、供給業者のリストを含む建設計画の提出を求められます。また、申請者は、提案されたプロジェクト、およびプロジェクト内の個々の活動について、必要な環境コンプライアンスおよび許認可のステップを特定する必要があります。

#### e. 労働力および地域社会への投資 (Workforce and Community Investment) <sup>22</sup>

申請者は、①建設・施設労働者への投資戦略、および②地域社会への投資戦略を定めた「労働力および地域社会への投資」計画 (“Workforce and Community Investment” Plan) を提出することが求められます。

労働力開発について、申請者は、自らの施設における多様な労働力の募集、訓練、雇用、維持、技能向上に関する戦略を明らかにする必要があります<sup>23</sup>。また、申請者は、「地域の教育・訓練機関や高等教育機関からの、経済的に恵まれない人々の訓練や就職斡旋を含む労働力訓練を提供する旨の確約」を確保することが求められます。さらに、施設労働者と建設労働者の両方について、経済的に不利な立場にある個人へのアクセスをどのように拡大するかを文書化しなければなりません。

地域社会への投資について、商務省は、申請者が地域社会の関係者と緊密に協力し、研究機関や教育機関への投資等、地域のニーズに対応した一連の投資計画を策定することを期待しています。また、幅広い利害関係者や地域社会に利益をもたらすため、小規模な企業やマイノリティ・退役軍人・女性が経営する企業がプロジェクトに包摂されることを確保する積極的措置を講じることが奨励されています<sup>24</sup>。

### 5. ガードレールの概要

CHIPS 法は、本プログラムによる資金援助を受ける技術革新が、敵対国により、米国および同盟国に対して悪意的に利用されることを防ぐため、ガードレール (Guardrails) と呼ばれる対抗策を設けています。2023 年 3 月 21 日、NIST は、ガードレールの定義や詳細について定める規則案通知を公表し、パブリックコメントを募集しました<sup>25 26</sup>。同年 9 月 25 日には最終規則 (以下「最終規則」) が公表され、同年 11 月 24 日に発効しています<sup>27 28</sup>。ガードレールの概要は以下のとおりです。

### (1) 懸念ある外国事業体への付与の禁止

CHIPS 法により、本プログラムの審査における考慮事項として、商務長官は、懸念国 (Foreign Country of Concern) が所有・支配する事業体等を含む「懸念ある外国事業体」 (Foreign Entity of Concern) による申請を承認できないものとされています<sup>29</sup>。

最終規則において、懸念国とは、①10 U.S.C. § 4872 (d) に定義される対象国 (北朝鮮、中国、ロシア、イラン) および②商務長官が米国の国家安全保障および外交政策に有害な行為に及んでいると判断した国をいうものと定義されています<sup>30</sup>。また、懸念ある外国事業体の定義については、①外国テロ組織 (Foreign Terrorist Organization) として指定されている外国事業体、②財務省の特別指定国民および資格停止者リスト (SDN リスト) に記載されているか、または SDN リストに記載されている個人・事業体が発行済議決権総数の 50%以上を保有する外国事業体、③懸念国の政府により所有・支配され、またはその管轄・指示に服する外国事業体等の 7 項目が挙げられています<sup>31</sup>。

### (2) 拡張クローバック (Expansion Clawback)<sup>32</sup>

CHIPS 法は、CHIPS インセンティブの付与を受けた者 (以下「受益者」) またはその関連グループのメンバー (Members of the Affiliated Group)<sup>33</sup> に対し、当該交付決定を受けた日から 10 年間、懸念国における半導体製造能力の実質的な拡張 (Material Expansion) を伴う重要な取引に関与することを制限し、これを伴う可能性のある重要な取引の計画について事前届出を義務付けています。商務長官は、届出の受領から 90 日以内に、当該取引が上記制限に違反するかを決定・通知し、違反する旨の決定を受けた受益者は、当該決定から 45 日以内に、当該取引が中止または放棄されたことを証明する書類を提出する必要があります<sup>34</sup>。受益者がこれに従わない場合、商務長官は、付与された CHIPS インセンティブの返還を求めます<sup>35 36</sup>。

最終規則において、実質的な拡張とは、クリーンルーム、製造ライン、またはその他の物理的なスペースの追加、またはそれらの組み合わせにより、既存の施設の半導体製造能力を 5%以上増加させるものをいうとされています<sup>37</sup>。例外として、①レガシー半導体を製造するための既存の施設・設備、または②レガシー半導体を製造し、主として懸念国の市場に供給する半導体製造能力の実質的な拡張を伴う重要な取引については、上記制限の適用が除外されます<sup>38 39</sup>。ただし、半導体製造能力を 10%以上増加させる大幅な改修 (Significant Renovations) を行った施設は「既存の施設」に該当しなくなるため<sup>40</sup>、レガシー半導体を製造するための既存の施設または設備において半導体製造能力を 10%以上増加させる場合には、①の適用除外の対象から外れることになります。

### (3) 技術クローバック (Technology Clawback)

CHIPS 法は、受益者に対し、当該付与決定の適用期間中、国家安全保障上の懸念を生じさせる技術または製品<sup>41</sup>について、故意に、懸念ある外国事業体との共同研究<sup>42</sup>または技術ライセンス<sup>43</sup>を行うことを制限し、これに違反した場合は付与された CHIPS インセンティブ返還を求める旨を定めています<sup>44</sup>。また、最終規則では、懸念ある外国事業体の関連事業体 (Related Entity)<sup>45</sup> との共同研究または技術ライセンスを行うことも制限されています。

## 6. おわりに

本プログラムは、米国および同盟国の技術・国家安全保障上の優位性を高め、今後数十年にわたり中国等の懸念国の先に立つことを念頭に、半導体産業に大規模な予算を充てるものであり、半導体のグローバルサプライチェーンに大きな影響を及ぼすことが予想されます。在米日系企業からは、申請者が満たさなければならない要件や順守すべき条件が想定以上に厳しいとの見方がある一方、半導体製造業者等による投資拡大によりサプライチェーン上流への発注が増える可能性を期待する声も出ています<sup>46</sup>。

今後公表が予定されている資金援助機会もあり、引き続き、本プログラムの動向が注目されます。

1 資金援助機会の第 1 弾では全 78 頁にわたる NOFO (脚注 5)、第 2 弾では全 45 頁にわたる NOFO (脚注 9) が公表されており、本稿でそのすべてを網羅することはできません。各機会での申請を具体的に検討される際は、NOFO その他の参考資料をご参照ください。

2 [Pub. L. 116-283](#), § 9901-9908, 134 Stat. 3388, 4843-4860 (2021) (codified at 15 U.S.C. § 4651-4657) .

3 [Pub. L. 117-167](#), § 101-107, 136 Stat. 1366, 1372-1399 (2022) (codified as amended at 15 U.S.C. § 4651-4843) . 「CHIPS および科学法」の他、「CHIPS プラス法」とも呼ばれています。

4 NSTC は、CHIPS 法により、先端半導体技術の研究およびプロトタイピングを行う施設として設置されました。CHIPS 法に基づく研究開発イニシアチブの中核的存在とされています。15 U.S.C. § 4656 (c) .

5 脚注 7 ([NOFO 第 1 弾](#))、§ I.B.3.

6 NIST, [Funding Opportunity - Commercial Fabrication Facilities, FACT SHEET : CHIPS Program Office Launches Notice of Funding Opportunity](#) (Feb. 28, 2023) .

- 7 NIST, [NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY \(NOFO\) : CHIPS Incentives Program - Commercial Fabrication Facilities](#) (June 23, 2023) .
- 8 資本投資額 (Capital Investment) とは、当該プロジェクトの建設、拡張、近代化を完了し、運営を開始するために必要な費用をいい、土地、建設、設備、インフラの改善、建設、拡張、建設に直接寄与する管理費等のカテゴリーに分類されるとされています。脚注 7 ([NOFO 第 1 弾](#))、§ IV. I. 7.
- 9 NIST, [NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY \(NOFO\) : CHIPS Incentives Program - Facilities for Semiconductor Materials and Manufacturing Equipment](#) (Sep. 29, 2023) .
- 10 脚注 9 ([NOFO 第 2 弾](#))、§ I. B. 1.
- 11 重要製造業 (Critical Manufacturing Industry) の定義について、脚注 7 ([NOFO 第 1 弾](#))、§ VII. A. 機械製造業、自動車製造業、コンピューター・エレクトロニクス製造業等の 11 項目が挙げられています。
- 12 参考資料として、CPO, [CHIPS for America, Workforce Development Planning Guide : Guidance for CHIPS Incentives Applicants](#) (Mar. 27, 2023) .
- 13 参考資料として、U. S. Department of Commerce & U. S. Department of Labor, [Good Jobs Principles](#) (2022) .
- 14 1 億 5, 000 万ドル以上の CHIPS 直接資金を受ける申請者は、申請者の予測を上回るキャッシュフローまたはリターンの一部を米国政府と共有することが義務付けられています。
- 15 参考資料として、CPO, [CHIPS for America, Creating Inclusive Opportunities for Businesses Guide](#) (Aug. 21, 2023) .
- 16 申請者は、米国内で生産された鉄、鋼、および建設資材を利用する計画の有無とその方法について説明する必要があります。
- 17 NOFO の変更・終了は、<https://www.grants.gov> または <https://www.nist.gov/chips> により通知されます。
- 18 実質的でない情報が欠落している場合で、その欠落が審査プロセスにおいて容易に修正可能であるときは、商務省の裁量により審査を継続することができます。
- 19 脚注 9 ([NOFO 第 2 弾](#))、§ V. A. 参照。概要、①米国の活気ある製造クラスターの支援、サプライチェーンの強靱性の強化、米国の技術リーダーシップの促進により、米国の経済および国家安全保障を強化する程度 (40 点)、②長期的な商業的実行可能性 (成果物に対する強固な顧客需要の実証の程度を含む) (20 点)、③米国内の施設や設備への投資を申請者が行う動機付けとなる理由に係る正当性の強さと妥当性 (10 点)、④プロジェクトの成功可能性 (申請者の経験値、実行可能な計画の有無を含む) (15 点)、⑤CHIPS インセンティブ以外の資金源の利用可能性と信頼性 (15 点) の 5 項目が挙げられています。

- 20 脚注 9 ([NOFO 第 2 弾](#))、§ V.B. 参照。概要、①戦略目標の組み合わせおよび幅、② CHIPS インセンティブがなくともプロジェクトが同様に進行する可能性、③リスクプロファイルの影響の程度、④他の連邦機関から資金提供を受けるプロジェクトとの重複の程度、⑤過去に CHIPS インセンティブを受けたことがあるか等の点を含む 9 項目が挙げられています。
- 21 脚注 9 ([NOFO 第 2 弾](#))、§ V.C. 参照。概要、①米国のクラスターの支援、サプライチェーンの強靱性の強化、米国の技術リーダーシップの促進により、米国の経済および国家安全保障を強化する程度、②サイバーセキュリティ、運用セキュリティ、サプライチェーンの強靱性等、国家安全保障上の考慮事項に対応している程度、③成果物に対する合理的な市場環境と需要の程度、また半導体産業への貢献の程度等を含む 7 項目に基づいて、総合的かつ定性的に評価するものとされています。
- 22 脚注 12 ([Workforce Development Planning Guide](#)) 参照。
- 23 脚注 13 ([Good Jobs Principles](#)) 参照。
- 24 脚注 15 ([Creating Inclusive Opportunities for Businesses Guide](#)) 参照。
- 25 NIST, [National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program](#) (Mar. 21, 2023) .
- 26 [88 Fed. Reg. 17439](#) (Mar. 23, 2023) (to be codified at 15 C.F.R. § 231) .
- 27 NIST, [Biden-Harris Administration Announces Final National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program](#) (Sep. 22, 2023) .
- 28 [88 Fed. Reg. 65600](#) (Sep. 25, 2023) (to be codified at 15 C.F.R. § 231) .
- 29 15 U.S.C. § 4652 (a) (2) (C) (v) .
- 30 15 C.F.R. § 231.102.
- 31 15 C.F.R. § 231.104.
- 32 一般に、「クローバック」(Clawback) とは、あるトリガーが生じた場合に、既に支払われた金銭等を返還させる旨の仕組みをいいます。
- 33 [26 U.S.C. § 1504](#) (a) に定義される「関連グループ」(80%議決権・価値テスト等の基準により判断) に含まれる事業体をいうものと定義されています。15 C.F.R. § 231.109.
- 34 受益者は、違反する旨の決定から 14 日以内に再評価の申し立てを行うことができ、同場合、商務長官は申し立ての受領から 60 日以内に最終決定を行います。違反する旨の最終決定を受けた受益者は、当該決定から 45 日以内に、当該取引が中止・放棄されたことを証明する書類を提出する必要があります。15 C.F.R. § 231.305 (c) .
- 35 15 U.S.C. § 4652 (a) (6) . 受益者は、CHIPS インセンティブの付与を受ける前に、商務長官とこのような拡張クローバック条項を含む合意書を締結することになります。

- 36 商務長官は、受益者に対し、修正合意書の締結を含む国家安全保障上のリスクを緩和する措置を講じるよう求めることができ、このような修正合意書が締結・順守された場合には、CHIPS インセンティブの返還請求権の全部または一部を放棄する裁量権を有します。15 C.F.R. § 231.307.
- 37 15 C.F.R. § 231.108.
- 38 レガシー半導体 (Legacy Semiconductor) とは、一般に非先端の半導体 (現世代・成熟ノード半導体) を指しますが、詳細な定義は 15 C.F.R. § 231.107 に定められています。なお、商務省は、2023 年 12 月 21 日、中国によるレガシー半導体の生産拡大等の兆候に鑑み、国家安全保障上のリスクを抑制するための政策に役立てるため、米国商務省産業安全保障局 (Bureau of Industry and Security : BIS) において、2024 年 1 月より米国の重要産業のサプライチェーンにおける中国製のレガシー半導体の使用および調達に焦点を当てた調査を開始する旨を公表しました。U.S. Department of Commerce, [Commerce Department Announces Industrial Base Survey of American Semiconductor Supply Chain](#) (Dec. 21, 2023) .
- 39 15 U.S.C. § 4652 (a) (6) (C) (ii) .
- 40 15 C.F.R. §§ 231.101, 231.119.
- 41 国家安全保障上の懸念を生じさせる技術または製品 (Technology or Product that raises national security concerns) の定義について、15 C.F.R. § 231.121.
- 42 共同研究 (Joint Research) の定義について、15 C.F.R. § 231.105. ①規格関連活動、②受益者の従業員間または受益者・関連事業者間および関連事業者間で排他的に行われる研究開発、③集積回路のファウンドリ、アセンブリ、テスト、またはパッケージング・サービスの利用を可能にすることのみを目的とする既存製品の製造工程に関連する研究、開発、またはエンジニアリング等の 5 項目が除外されています。
- 43 技術ライセンス (Technology Licensing) の定義について、15 C.F.R. § 231.120. ①標準必須特許およびクロスライセンス活動を含む特許ライセンス、②受益者・関連事業者間、または関連事業者間で排他的に行われるライセンス契約・移転契約、③規格関連活動等の 9 項目が除外されています。
- 44 15 U.S.C. § 4652 (a) (5) (C) . 受益者は、CHIPS インセンティブの付与を受ける前に、商務長官とこのような技術クローバック条項を含む合意書を締結することになります。
- 45 関連事業体とは、直接的または間接的に、受益者を支配する、または受益者に支配される、または受益者と共通の支配下にある事業体をいうものとされています。15 C.F.R. § 231.204.
- 46 日本貿易振興機構 (JETRO) 「[始動した CHIPS プログラム、サプライチェーンに与える影響は \(米国\)](#)」 (2023 年 5 月 8 日)。

※免責事項：上記の内容は、一般的な説明にすぎません。具体的な状況に応じた法的助言または専門家意見として解釈しないようご注意ください。ご不明な点がございましたら、SGR 法律事務所までお問い合わせください。

M000462-22

(2023年12月30日作成)

## Profile



小島 清顕 Kiyooki Kojima



スミス・ガンブレレル・ラッセル(SGR)法律事務所  
パートナー・米国弁護士

日本出身（地元：神奈川県小田原市）、幼少期から米国在住。ロチェスター大学で政治・経済学を専攻。同時期に、イーストマン音楽学校にてファゴットも専攻・学位取得。学位取得後、インディアナ大学ロースクールと音学校に同時進学・卒業。JD取得後、2003年からホームタウンのジョージア州アトランタ市を拠点に米国各地で弁護士業務を営む。主に法人設立・交渉・各種取引アドバイス、合併・合弁・ライセンス、雇用・労務、紛争防止・対応、知的財産管理・活用、企業誘致・土地選定・助成金交渉その他各種幅広い法務に対応しています。

## Profile



岡本 駿之 Shunji Okamoto



スミス・ガンブレレル・ラッセル(SGR)法律事務所  
カウンセラー・弁護士

茨城県立土浦第一高校、一橋大学法学部を卒業後、立教大学法科大学院修了。2010年12月に弁護士登録（63期）。都内法律事務所にて、紛争解決、M&A、株主総会対応、法人設立、人事労務、倒産案件等の企業法務を主に担当。また、個人の依頼者からの一般民事（労働関係、不動産関係、損害賠償事件）、家事事件（相続）も取り扱う。2020年8月に渡米し、2021年5月米国コーネル大学ロースクール修了。2021年8月から1年間SGR法律事務所の交換弁護士として勤務。2023年10月に再度渡米し、SGR法律事務所のJapan Practice Teamに加わる。

## Profile



白水 真祐 Mayu Shiromizu



スミス・ガンブレレル・ラッセル(SGR)法律事務所  
交換弁護士

福岡県大牟田市出身。2012年大阪大学法学部国際公共政策学科卒業、2015年京都大学法科大学院修了。2017年に弁護士登録。弁護士法人三宅法律事務所にて執務し、会社法関連各種業務の他、金融法務、人事労務、ビジネスと人権等を主たる業務分野として対応。2023年米国バージニア大学ロースクール（LL.M.）修了。同年10月よりSGR法律事務所にて交換弁護士として執務。主要著作として『金融機関の法務対策6000講』（共著 金融財政事情研究会、2022年）。